

露笑科技股份有限公司 董事会关于募集资金 2026 年 1-6 月存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2026 年 6 月 30 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1132 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由联席主承销商国泰海通证券股份有限公司及中国国际金融股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 31,933.4577 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.04 元。截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司共募集资金 2,567,449,999.08 元，扣除发行费用 54,923,900.54 元，募集资金净额 2,512,526,098.54 元，业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字（2022）第 332C000375 号《验资报告》验证。

（二）募集资金本年度使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 130,158.76 万元（含补充流动资金以及调整募投项目规模后将节余募集资金永久补充流动资金项目），其中 2026 年 1-6 月投入募投项目 2,863.72 万元，调整募投项目规模后将节余募集资金永久补充流动资金 95,000.00 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，存放于募集资金专户的余额为人民币 229.93 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	募集资金发生额
募集资金净额	251,252.61
减：以前年度累计投入募投项目金额（含补充流动资金项目）	32,295.03
减：2026 年 1-6 月投入募投项目金额	2,863.72

项目	募集资金发生额
减：暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额	125,600.00
减：调整募投项目规模后将节余募集资金永久补充流动资金	95,000.00
加：累计利息收入和理财收益扣除手续费支出等金额后的净额	4,736.07
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	229.93

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《露笑科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户，具体情况如下：

序号	项目名称	户名	开户行	账号
1	募集资金总账户	露笑科技股份有限公司	中信银行杭州庆春支行	8110801012502477211
2	第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目	合肥露笑半导体材料有限公司	中国农业银行股份有限公司诸暨支行	19531201040013486
3	第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目	合肥露笑半导体材料有限公司	浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行	3371020310120100270168
4	第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目	合肥露笑半导体材料有限公司	平安银行股份有限公司绍兴分行	15116118118883
5	第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目	合肥露笑半导体材料有限公司	中国银行股份有限公司诸暨支行	371481316261
6	大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目	合肥露笑半导体材料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行	85050078801000001275

关于上述募集资金专户，公司及控股子公司合肥露笑半导体材料有限公司与各方签订了六份募集资金监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。监管协议具体签订情况如下：

（1）2022 年 6 月，公司已和保荐人国泰海通证券股份有限公司、中信银行股份有限公司杭州庆春支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(2) 2022 年 6 月,公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐人国泰海通证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(3) 2022 年 6 月,公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐人国泰海通证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行,签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(4) 2022 年 6 月,公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐人国泰海通证券股份有限公司与平安银行股份有限公司绍兴分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(5) 2022 年 6 月,公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐人国泰海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司诸暨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(6) 2022 年 6 月,公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐人国泰海通证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2026 年 6 月 30 日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币万元

银行名称	账号	截止日余额	储存方式
中信银行杭州庆春支行	8110801012502477211	68.43	活期
中国农业银行股份有限公司诸暨支行	19531201040013486	1.72	活期
浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行	3371020310120100270168	81.42	活期
平安银行股份有限公司绍兴分行	15116118118883	5.75	活期
中国银行股份有限公司诸暨支行	371481316261	22.46	活期
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行	85050078801000001275	50.14	活期
合计		229.93	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

本公司 2026 年度 1-6 月募集资金实际使用情况详见本报告附表 1《2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 1 月 18 日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为了加快公司票据的周转速度，合理改进募集资金投资项目款项支付方式，降低公司财务成本并提高募集资金的使用效率，公司在募集资金投资项目实施期间，拟根据实际情况使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 2 月 9 日，本公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 150,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2024 年 1 月 16 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 150,000 万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

2024 年 1 月 17 日，本公司召开第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 170,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2024 年 11 月 19 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 170,000 万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

2024 年 11 月 20 日，本公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 183,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

2025 年 11 月 7 日，本公司召开的第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，部分募集资金存在暂时闲置的情况，为提高公

司募集资金使用效率,满足公司日常经营对流动资金增加的需求,减少公司的财务费用支出,优化财务结构,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟延期归还闲置募集资金 183,000 万元并继续用于暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2026 年 1-6 月累计归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 57,400.00 万元至募集资金专户,使用期限未超过十二个月。截至 2026 年 6 月 30 日,公司尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 125,600.00 万元。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

2025 年 5 月 14 日,本公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用部分募集资金不超过 50,000 万元进行现金管理,期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品已全部到期赎回,现金管理产品本金及收益已经及时归还至公司募集资金专用账户,存放于现金管理专用结算账户余额为 0.00 万元。

(六) 结余募集资金使用情况

本报告期内,公司不存在使用募投项目结余资金的情况。

(七) 超募资金使用情况

本报告期内,公司不存在超募资金使用情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金目前存放于公司开立的银行募集资金专户中或用于临时补充流动资金,公司将按照募集资金投资项目的后续进展投入使用。截至 2026 年 6 月 30 日,公司存放在募集资金专户的银行存款余额为 229.93 万元,用于暂时补充流动资金的金额为 125,600.00 万元。

(九) 募集资金使用的其他情况

本报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2026 年 1 月 16 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”募集资金计划投资总额由 194,000.00 万元调整为 99,000.00 万元，并将前述募投项目募集资金调减的 95,000.00 万元用于永久补充流动资金。

2026 年 7 月 7 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，结合当前募投项目实际进展情况及近年来碳化硅衬底片行业变化情况，公司拟终止募投项目“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”和“大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目”，剩余募集资金将用于永久补充流动资金。2026 年 7 月 23 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会审议通过了上述议案。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

露笑科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附表 1:

2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况表

编制单位：露笑科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		251,252.61			本年度投入募集资金总额			97,863.72		
报告期内变更用途的募集资金总额		95,000.00			已累计投入募集资金总额			130,158.76		
累计变更用途的募集资金总额		95,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		37.81%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目	是	194,000.00	99,000.00	1,912.56	14,673.96	14.82	已终止	不适用	不适用	是
大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目	否	50,000.00	44,507.61	951.16	7,739.79	17.39	已终止	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	12,745.00	12,745.00	-	12,745.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
调整“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”投资规模并将节余募集资金用于永久补充流动资金	—	-	95,000.00	95,000.00	95,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		256,745.00	251,252.61	97,863.72	130,158.75					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）		受整体宏观经济波动，项目实施过程中关于建设、调试、生产等方面的不确定性，以及碳化硅行业市场环境变化等因素影响，公司对相关募集资金投资项目进度有所放缓，无法在原预定可使用状态日期前完成。 为降低募集资金投资风险，保障资金安全，确保募集资金合理运用，本着谨慎使用募集资金及维护全体股东权益的原则，结合公司当前募集资金投资项目的开展情况，本公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目及大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目达到预定可使用状态日期调整至 2026								

	年6月30日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	近年来，受到宏观经济波动、国际贸易政策变化等因素影响，募投项目“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”和“大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目”面临的市场环境存在较大不确定性，6英寸碳化硅衬底市场供给逐渐饱和，市场竞争加剧，行业扩张速度明显放缓。为控制投资风险，公司对募投项目的投资进度有所放缓。公司已于2026年1月16日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”募集资金计划投资总额由194,000.00万元调整为99,000.00万元，并将前述募投项目募集资金调减的95,000.00万元用于永久补充流动资金。 公司综合考虑募投项目的实际建设情况及未来发展规划，继续投入募集资金建设上述项目，将增加公司固定成本、降低公司盈利水平、增加公司投资风险。因此，公司经审慎考虑，拟终止“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”及“大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目”，剩余募集资金将用于永久补充流动资金。公司将在本次终止募投项目并永久补充流动资金事项的股东会审议通过，且上述正用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户后，再实施本次永久补充流动资金。上述募投项目的募集资金专户将在剩余募集资金转出后予以注销，相应的募集资金三方监管协议亦将终止。该事项已于2026年7月7日经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过、于2026年7月23日经公司2026年第三次临时股东会审议通过。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	2025年5月14日，本公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用部分募集资金不超过50,000万元进行现金管理，期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品已全部到期赎回，现金管理产品本金及收益已经及时归还至公司募集资金专用账户，存放于现金管理专用结算账户余额为0.00万元。公司综合考虑募投项目的实际建设情况及未来发展规划，继续投入募集资金建设上述项目，将增加公司固定成本、降低公司盈利水平、增加公司投资风险。因此，公司经审慎考虑，拟终止“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”，剩余募集资金将用于永久补充流动资金。该事项已于2026年7月7日经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过、于2026年7月23日经公司2026年第三次临时股东会审议通过。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目	第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目	99,000.00	1,912.56	14,673.96	14.82	已终止	不适用	不适用	是
永久补充流动资金	第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目	95,000.00	95,000.00	95,000.00	100	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计		194,000.00	96,912.56	109,673.96					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					近年来因行业总体竞争格局、市场环境发生较大变化，6 英寸导电型碳化硅衬底市场竞争较为激烈，经全面评估后，公司决定调减“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”的投资规模。2026 年 1 月 16 日公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目”募集资金计划投资总额由 194,000.00 万元调整为 99,000.00 万元，并将前述募投项目募集资金调减的 95,000.00 万元用于永久补充流动资金。				
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）					不适用				

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	公司综合考虑募投项目的实际建设情况及未来发展规划，继续投入募集资金建设上述项目，将增加公司固定成本、降低公司盈利水平、增加公司投资风险。因此，公司经审慎考虑，拟终止“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”，剩余募集资金将用于永久补充流动资金。该事项已于 2026 年 7 月 7 日经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过、于 2026 年 7 月 23 日经公司 2026 年第三次临时股东会审议通过，详见公司相关公告。
----------------------	---